

2025-2031年中国半导体晶圆搬运设备市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2025-2031年中国半导体晶圆搬运设备市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/S0271641N6.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2025-08-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2025-2031年中国半导体晶圆搬运设备市场分析与投资前景研究报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制,全面剖析了中国半导体晶圆搬运设备市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议,规避市场风险,全面掌握行业动态。

第1章半导体晶圆搬运设备行业综述及数据来源说明1.1 半导体设备行业界定1.1.1 芯片制
程工艺流程及设备需求1.1.2 半导体设备类型1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中半导体设备
行业归属1.2 半导体晶圆搬运设备行业界定1.2.1 半导体晶圆搬运设备的重要性1.2.2 半导体自动
物料搬运系统 (AMHS) 1.2.3 半导体晶圆搬运设备专业术语1.3 本报告研究范围界定说明1.4
半导体晶圆搬运设备行业监管规范体系1.4.1 半导体晶圆搬运设备行业监管体系介绍1、中国半
导体晶圆搬运设备行业主管部门2、中国半导体晶圆搬运设备行业自律组织1.4.2 半导体晶圆搬
运设备制造企业应取得《特种设备制造许可证》1.4.3 半导体晶圆搬运设备行业标准体系建设
现状1.5 本报告数据来源及统计标准说明1.5.1 本报告权威数据来源1.5.2 本报告研究方法
及统计标准说明第2章全球半导体晶圆搬运设备行业发展现状及市场趋势洞察2.1 全球半导体晶圆搬
运设备行业发展历程介绍2.2 全球半导体晶圆搬运设备行业技术发展现状2.3 全球半导体晶圆
搬运设备行业发展现状分析2.3.1 全球半导体晶圆搬运设备行业兼并重组状况2.3.2 全球半导体
晶圆搬运设备行业市场竞争格局2.3.3 全球半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况2.3.4 全球半
导体晶圆搬运设备行业市场贸易状况2.3.5 全球半导体晶圆搬运设备行业细分市场分析2.4 全球
半导体晶圆搬运设备行业市场规模体量及趋势前景预判2.5 全球半导体晶圆搬运设备行业区域
发展格局及重点区域市场评估2.6 全球半导体晶圆搬运设备行业发展经验借鉴第3章中国半导
体晶圆搬运设备行业发展现状及市场痛点解析3.1 中国半导体晶圆搬运设备行业技术发展现
状3.1.1 半导体行业技术迭代历程3.1.2 半导体晶圆搬运设备效率影响因素分析3.1.3 半导体晶圆
搬运设备行业科研投入水平3.1.4 中国半导体晶圆搬运设备行业科研和创新状况3.1.5 中国半导
体晶圆搬运设备行业专利申请及公开情况3.1.6 半导体晶圆搬运设备行业最新技术动态3.2 中国
半导体晶圆搬运设备行业发展历程介绍3.3 中国半导体晶圆搬运设备行业对外贸易状况3.3.1 中
国半导体晶圆搬运设备行业进出口贸易概况3.3.2 中国半导体晶圆搬运设备行业进口贸易状
况3.3.3 中国半导体晶圆搬运设备行业出口贸易状况3.3.4 中国半导体晶圆搬运设备行业进出口
贸易影响因素及发展趋势3.4 中国半导体晶圆搬运设备行业市场主体分析3.5 中国半导体晶圆
搬运设备行业招投标市场解读3.6 中国半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况3.6.1 中国半导体
晶圆搬运设备行业市场供给状况3.6.2 中国半导体晶圆搬运设备行业市场需求分布3.7 中国半导
体晶圆搬运设备行业市场规模体量3.7.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场规模测算逻辑3.7.2

中国半导体晶圆搬运设备行业市场规模3.8 中国半导体晶圆搬运设备行业市场发展痛点第4章
中国半导体晶圆搬运设备行业市场竞争状况及融资并购4.1 中国半导体晶圆搬运设备行业市场
竞争布局状况4.2 中国半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局分析4.3 中国半导体晶圆搬运设
备行业国产替代布局与发展现状4.3.1 中国半导体晶圆搬运设备企业国际市场竞争参与状
况4.3.2 中国半导体晶圆搬运设备行业国产替代布局状况4.4 中国半导体晶圆搬运设备行业波特
五力模型分析4.4.1 中国半导体晶圆搬运设备行业供应商的议价能力4.4.2 中国半导体晶圆搬运
设备行业消费者的议价能力4.4.3 中国半导体晶圆搬运设备行业新进入者威胁4.4.4 中国半导体
晶圆搬运设备行业替代品威胁4.4.5 中国半导体晶圆搬运设备行业现有企业竞争4.4.6 中国半导
体晶圆搬运设备行业竞争状态总结4.5 中国半导体晶圆搬运设备行业投融资、兼并与重组状况
第5章中国半导体晶圆搬运设备产业链全景梳理及配套产业5.1 中国半导体晶圆搬运设备产业
链结构梳理5.2 中国半导体晶圆搬运设备产业链生态图谱5.3 中国半导体晶圆搬运设备产业链
区域热力图5.4 中国半导体晶圆搬运设备行业成本结构分析5.5 中国半导体晶圆搬运设备零部
件/组件市场分析5.5.1 半导体晶圆搬运设备零部件/组件概述5.5.2 半导体晶圆搬运设备零部件/
组件市场发展现状5.5.3 半导体晶圆搬运设备零部件/组件供给分析5.6 中国半导体晶圆搬运设
备软件控制系统分析5.6.1 半导体晶圆搬运设备软件控制系统概述5.6.2 半导体晶圆搬运设备软
件控制系统市场分析5.6.3 半导体晶圆搬运设备软件控制系统趋势前景5.7 中国半导体晶圆搬运
设备检测与维修市场分析5.7.1 半导体晶圆搬运设备检测与维修概述5.7.2 半导体晶圆搬运设备
检测与维修市场发展现状5.7.3 半导体晶圆搬运设备检测与维修市场趋势前景5.8 配套产业布局
对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结第6章中国半导体晶圆搬运设备行业中游市场发展
状况6.1 中国半导体晶圆搬运设备本体制造市场分析6.2 中国半导体晶圆搬运设备系统集成市
场分析6.3 中国半导体晶圆搬运机器人市场分析6.3.1 晶圆搬运机器人概述6.3.2 晶圆搬运机器人
市场发展现状6.3.3 晶圆搬运机器人发展趋势前景6.4 中国半导体自动物料搬运系统（AMHS）
市场分析6.4.1 半导体自动物料搬运系统（AMHS）概述6.4.2 半导体自动物料搬运系统
（AMHS）市场发展现状6.4.3 半导体自动物料搬运系统（AMHS）发展趋势前景第7章中国半
导体晶圆搬运设备行业下游应用市场分析7.1 中国半导体晶圆搬运设备行业下游应用场景/行
业领域分布7.1.1 中国半导体晶圆搬运设备应用场景分布7.1.2 中国半导体晶圆搬运设备应用领
域分布7.2 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析7.2.1 中国集成电路市场分
析7.2.2 集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求概述7.2.3 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设
备需求现状分析7.2.4 中国集成电路领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景7.3 中国传感器领域
半导体晶圆搬运设备需求潜力分析7.3.1 中国传感器市场分析7.3.2 传感器领域半导体晶圆搬运
设备需求概述7.3.3 中国传感器领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析7.3.4 中国传感器领域半
导体晶圆搬运设备需求趋势前景7.4 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析7.4.1

中国分立器件市场分析7.4.2 分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求概述7.4.3 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析7.4.4 中国分立器件领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景7.5 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求潜力分析7.5.1 中国光电器件市场分析7.5.2 光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求概述7.5.3 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求现状分析7.5.4 中国光电器件领域半导体晶圆搬运设备需求趋势前景7.6 中国半导体晶圆搬运设备行业细分应用市场战略地位分析第8章全球及中国半导体晶圆搬运设备企业案例研究8.1 全球及中国半导体晶圆搬运设备企业布局梳理与对比8.2 全球半导体晶圆搬运设备企业布局分析8.2.1 美国布鲁克斯自动化（Brooks）1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.2.2 日本Rorze1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.2.3 日本DISCO1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.2.4 日本电产三协株式会社1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3 中国半导体晶圆搬运设备企业布局分析8.3.1 上海大族富创得科技有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.2 菲科半导体（张家港）有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.3 上海果纳半导体技术有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.4 舜宇光学科技（集团）有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.5 昀智科技（北京）有限责任公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.6 济南翼菲自动化科技有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.7 东莞市智赢智能装备有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.8 沈阳新松机器人自动化股份有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.9 深圳优艾智合机器人科技有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析8.3.10 上海仙工智能科技有限公司1、企业概述2、竞争优势分析3、企业经营分析4、发展战略分析第9章中国半导体晶圆搬运设备行业发展环境洞察9.1 中国半导体晶圆搬运设备行业经济（Economy）环境分析9.1.1 中国宏观经济发展现状9.1.2 中国宏观经济发展展望9.1.3 中国半导体晶圆搬运设备行业发展与宏观经济相关性分析9.2 中国半导体晶圆搬运设备行业社会（Society）环境分析9.2.1 中国半导体晶圆搬运设备行业社会环境分析9.2.2 社会环境对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结9.3 中国半导体晶圆搬运设备行业政策（Policy）环境分析9.3.1 国家层面半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总及解读1、国家层面半导体晶圆搬运设备行业政策汇总及解读2、国家层面半导体晶圆搬运设备行业规划汇总及解读9.3.2 31省市半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总及解读1、31省市半导体晶圆搬运设备行业政策规划汇总2、31省市半导体晶圆搬运设备行业发展目标解读9.3.3 国家重点规划/政策对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响1、国家“十四五”规划对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响2

、“碳达峰、碳中和”战略对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响9.3.4 政策环境对半导体晶圆搬运设备行业发展的影响总结9.4 中国半导体晶圆搬运设备行业SWOT分析第10章中国半导体晶圆搬运设备行业市场趋势分析及发展趋势预判10.1 中国半导体晶圆搬运设备行业发展潜力评估10.2 中国半导体晶圆搬运设备行业未来关键增长点分析10.3 中国半导体晶圆搬运设备行业趋势预测分析10.4 中国半导体晶圆搬运设备行业发展趋势预判第11章中国半导体晶圆搬运设备行业投资规划建议规划策略及建议11.1 中国半导体晶圆搬运设备行业进入与退出壁垒11.1.1 半导体晶圆搬运设备行业进入壁垒分析11.1.2 半导体晶圆搬运设备行业退出壁垒分析11.2 中国半导体晶圆搬运设备行业投资前景预警11.3 中国半导体晶圆搬运设备行业投资机会分析11.3.1 半导体晶圆搬运设备行业产业链薄弱环节投资机会11.3.2 半导体晶圆搬运设备行业细分领域投资机会11.3.3 半导体晶圆搬运设备行业区域市场投资机会11.3.4 半导体晶圆搬运设备产业空白点投资机会11.4 中国半导体晶圆搬运设备行业投资价值评估11.5 中国半导体晶圆搬运设备行业投资前景研究与建议11.6 中国半导体晶圆搬运设备行业可持续发展建议图表目录图表1：半导体芯片制作前道工艺和后道工艺简介图表2：半导体芯片制作分工示意图图表3：中国半导体晶圆制作工艺及流程图表4：半导体设备类型图表5：《国民经济行业分类与代码》中半导体设备行业归属图表6：半导体搬运设备重要性图表7：半导体晶圆搬运设备的界定图表8：半导体自动物料搬运系统布局情况图表9：半导体晶圆搬运设备专业术语说明图表10：本报告研究范围界定图表11：中国半导体晶圆搬运设备行业监管体系图表12：中国半导体晶圆搬运设备行业主管部门图表13：中国半导体晶圆搬运设备行业自律组织图表14：中国半导体晶圆搬运设备标准体系建设图表15：中国半导体晶圆搬运设备现行标准汇总图表16：中国半导体晶圆搬运设备即将实施标准图表17：中国半导体晶圆搬运设备重点标准解读图表18：本报告权威数据资料来源汇总图表19：本报告的主要研究方法 & 统计标准说明图表20：全球半导体晶圆搬运设备行业发展历程图表21：全球半导体晶圆搬运设备企业兼并重组状况图表22：全球半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局图表23：全球半导体晶圆搬运设备行业兼并重组状况图表24：全球半导体晶圆搬运设备行业市场竞争格局图表25：全球半导体晶圆搬运设备行业市场供需状况图表26：全球半导体晶圆搬运设备行业市场贸易状况图表27：2024年全球半导体晶圆搬运设备相关细分领域投资支出结构（单位：亿美元，%）图表28：2020-2024年全球半导体行业销售额预测（单位：亿美元，%）图表29：2020-2024年全球半导体及晶圆厂设备规模（单位：亿美元）图表30：2020-2024年全球半导体晶圆搬运设备市场规模（单位：亿美元）更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/S0271641N6.html>